

ボーン・プロファイラー



1 正確

ヒーリング・アバットメントや補綴コンポーネントを正しい位置に装着できるよう、正確で均一なエマージェンス・プロファイルに仕上げます。

2 シンプル

ガイドピンが一体型となったワンピースタイプのボーン・プロファイラーです。ラッチロックタイプで、ハンドピースで使用します。また専用アダプターなどに装着し手動での使用も可能です。

3 最適なデザイン

切断効率を高めるデザインで、迅速な骨除去を行えます。

ガイドライン



○ TSV / Trabecular Metal



○ サर्टン・インターナル



○ ロー・プロファイル
サーテン・インターナル



○ エクスターナル・ヘクス



○ ロー・プロファイル
エクスターナル・ヘクス

ボーン・プロファイラーは、インプラントのプラットフォーム周辺の余剰骨除去を行うために使用します。

ヒーリング・アバットメント、印象コーピング、補綴コンポーネント、最終補綴物を正確な位置に装着することが可能になります。

特に骨縁下に埋入されたインプラントに有効的です。また必要に応じて、歯槽骨縁上に埋入されたインプラントにも使用します。

ボーン・プロファイラーについて

・ボーン・プロファイラーの使用回数は、15 回までです。

使用回数は、使用した骨の硬さ、適切な取り扱いなど、さまざまな要因に依存します。過剰な使用や滅菌の繰り返しなどが、切削効率に影響を与える可能性があります。

・使用時に摩耗などの確認が必要となります。カッティングエッジは欠けが無く、シャープであることが望ましいです。ラッチロック機構がついているシャンク（軸部）は、摩耗や傷によりマイクロモーターにダメージを与える可能性があります。

・ボーン・プロファイラーの推奨回転数は、50 rpm 以下です。

50 rpm を超えると、インプラントのプラットフォームおよび内部構造に損傷を与える可能性があります。

・ボーンプロファイラーは、ハンドピースに装着し使用します。手動で使用する場合は、T3:ISO1797アダプター [C9980]またはTSV / Trabecular Metal: マニュアル・ドライバー H[PR0035]に装着し使用します。

・使用前に、ボーン・プロファイラーとインプラントが正しい位置で装着していることをご確認ください。正しく装着される前にボーン・プロファイラーを回転させると、インプラントのプラットフォームおよび内部構造に損傷を与える可能性があります。

・ボーン・プロファイラーは未滅菌で提供されます。使用する前に洗浄、滅菌する必要があります。ボーン・プロファイラーの洗浄および滅菌手順については、添付文書を参照してください。

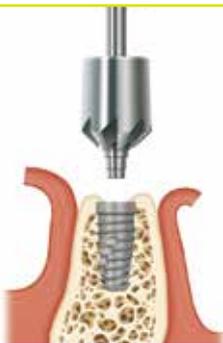
1



1. ボーン・プロファイラーを使用する器具に正しく装着されていることを確認します。
- ・ハンドピース使用の場合は、コントラアングル ハンドピースに装着し使用します。
- ・手動で使用する場合は、T3：ISO1797 アダプター[C9980] または TSV/Trabecular Metal：マニュアル・ドライバーH [PR0035] に装着し使用します。

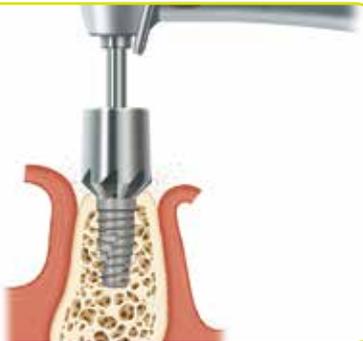
注：カバースクリュー上の余剰を取り除きカバースクリューを取り外した後、ボーンプロファイラーを使用してください。

2



2. 埋入されたインプラントにボーン・プロファイラーを装着し、ボーン・プロファイラーのガイドピンがインプラントと同軸に正しく装着されていることを確認します。

3



3. ボーン・プロファイラーがインプラントに正しく装着されたら、次の手順に従い使用します。
- ・ハンドピース使用の場合 - 時計回りに50 rpm以下でハンドピースを回転させます。
- ・手動の場合 - ボーン・プロファイラーをインプラントの軸方向に軽く圧を加え時計回りに回転させます。

注：最適な骨切削を行うには、骨片が刃先に付着していないことを確認してください。骨片の付着が多いと、ボーン・プロファイラーの切削効率が低下する可能性があり、またインプラントの損傷につながります。

4



4. 補綴コンポーネントがしっかり装着できるよう、余剰骨が十分に除去されるまで、ボーン・プロファイラーを使用します。

注：補綴コンポーネントを装着する前に、インプラントのプラットフォームおよび内部から、骨片を取り除きます。

3i サーテン・インターナル / エクスターナル・ヘクス用

・対応インプラント：T3* / Osseotite*

		製品番号	
プラットフォーム	エマーゼンス プロファイル	サーテン・インターナル	エクスターナル・ヘクス
3.4 mm	3.8 mm	BPC3438	BPX3438
	5.0 mm	BPC3450	BPX3450
4.1 mm	5.0 mm	BPC4150	BPX4150
	6.0 mm	BPC4160	BPX4160
	7.5 mm	BPC4175	BPX4175
5.0 mm	5.5 mm	BPC5055	BPX5055
	6.0 mm	BPC5060	BPX5060
	7.5 mm	BPC5075	BPX5075
6.0 mm	6.8 mm	BPC6068	BPX6068
	7.5 mm	BPC6075	BPX6075

☐ = 受注発注品

ロー・プロファイル・アバットメント用

・対応インプラント：T3* / Osseotite*

		製品番号	
プラットフォーム		サーテン・インターナル	エクスターナル・ヘクス
3.4 mm		BPCLP34	BPXLP34
4.1 mm		BPCLP41	BPXLP41
5.0 mm		BPCLP50	BPXLP50

TSV用

・対応インプラント：Tapered Screw-Vent* / Screw-Vent* / Trabecular Metal™

		製品番号
プラットフォーム	エマーゼンス プロファイル (フレア)	
3.5 mm	3.5 mm	BPT3535
	4.5 mm	BPT3545
	5.5 mm	BPT3555
4.5 mm	4.5 mm	BPT4545
	5.5 mm	BPT4555
	6.5 mm	BPT4565
5.7 mm	6.5 mm	BPT5765

TSV* Endoce® ヒーリング・アバットメント 対応表

・TSV エンコード・ヒーリング・アバットメントをご使用の際は、下記の対応表を参照し、ボーン・プロファイラーを選択します。

		製品番号	
プラットフォーム	エマーゼンス プロファイル (フレア)	TSV Encode ヒーリング アバットメント	TSV ボーン プロファイラー
3.5 mm	3.8 mm	TEHA3383	BPT3545
		TEHA3385	
		TEHA3387	
4.5 mm	5.0 mm	TEHA3503	BPT3555
		TEHA3505	
		TEHA4503	
4.5 mm	5.0 mm	TEHA4505	BPT4555
		TEHA4563	
		TEHA4565	
4.5 mm	5.6 mm	TEHA4567	BPT4565
		TEHA4603	
		TEHA4605	
5.7 mm	6.0 mm	TEHA5683	BPT4565
		TEHA5685	
5.7 mm	6.8 mm	TEHA5685	BPT5765

販売名：ボーンプロファイラー-2 届出番号：13B1X00079000144

●製造販売元

 ZimVie

ジンヴィ・ジャパン合同会社
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL.0120-418-890 FAX.0120-118-084

© 2022 ZimVie Japan G.K. All rights reserved. ZVJD0076 2022/10